

证券代码：002436

证券简称：兴森科技

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

2021 年 7 月 19 日投资者关系活动记录表

编号：2021-07-001

投资者关系 活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称 及人员姓名	国金证券：邓小路 国信证券：欧阳仕华 东吴证券：姚久花 前海圣耀资本：杨皓 浩期资管：郑金鹏 Cloudalpha capital（奇点资产管理有限公司）：谢明 3W Fund：杨文斌 深圳明达资产管理有限公司：查行楷
时间	10:00-11:10
地点	公司办公室
上市公司接待 人员姓名	副总经理、董事会秘书：蒋威 证券事务代表：王渝 证券事务助理：肖晓月
投资者关系活 动主要内容介 绍	<p>一、行业发展趋势分析</p> <p>公司自成立以来一直专注于 PCB 产业链，在上市之前专注于 PCB 样板领域，上市之后投资宜兴硅谷高多层板、IC 封装基板和半导体测试板领域，通过持续的研发投入和自身的积累实现技术、产品和客户的升级。</p> <p>参考 Prismark 的行业报告，从全球范围看，PCB 行业产能向国内转移的趋势已很明确且在持续进行中。过去十年，国内 PCB 行业在全球市</p>

场的份额提升至 54%，主要受益于中低端产能向国内转移的趋势；最近两年受益于国内 5G、数据中心等行业的驱动，国内高端产品的市场份额和竞争力逐步提升。从目前的情况看，以 IC 封装基板、anylayer HDI 板、8 层以上 PCB 产品的需求相对较好，供给增长的速度相对落后于需求增长的速度。考虑到 2018 年之后国内新上市的公司都有较大幅度的扩产，未来以单面板、双面板为代表的中低端产品会面临一定的压力。

二、公司情况简介

公司成立至今已 28 年，战略方向明确，始终坚守主业，专注于线路板产业，从传统的 PCB 样板、小批量板拓展至以 IC 封装基板、半导体测试板业务为代表的半导体业务，通过自身的研发投入和积累实现产品和技术的升级。未来公司仍会专注于主业，以 IC 封装基板作为主要投资和扩产的方向。

子公司宜兴硅谷二期项目（定增项目）主攻 5G、超算、光模块产品领域，从小批量进入大批量领域。通过 5G 业务进一步提升公司在高频、高速、高多层、高密度产品领域的能力，为后 5G 时代物联网应用的兴起打下基础。

三、2020 年度及 2021 年第一季度经营情况分析

2020 全年营收 40.34 亿元，同比增长 6.07%；净利润 5.21 亿元，同比增长 78.66%；扣除上海泽丰股权转让的投资收益 2.26 亿元，扣非净利润为 2.92 亿元，同比增长 13.62%。新产能投放、汇兑损失、商誉减值、激励费用摊销等对经营性利润形成部分拖累：样板和 IC 封装基板的新产能投放亏损约 4,500 万元，全年汇兑损失约 3,700 万元，子公司湖南源科商誉减值 1,073 万元，上海泽丰股权激励费用摊销约 1,200 万，这些因素对经营性利润的影响约 1 亿元左右。2020 年 Q3 是整个行业 and 公司的低潮，Q4 对公司而言是一个比较明显的经营拐点，单季度实现扣非净利润 6,995 万，同比增长 42.7%。

2021 年第一季度，实现净利润 1.01 亿元，同比增长 158.76%；扣除非经常损益后净利润 1.10 亿元，同比增长 215.06%。主要是在需求回暖和产能释放的背景下，收入规模增长，经营效率提升导致成本费用率下降和盈利能力提升。

从 2020 年 Q4~2021 年 Q1 的经营数据来看，公司整体效率有进一步的提升，成本管控的效果比较明显。

原材料受全球货币宽松、需求复苏及部分产品供给受限影响，今年

以来有较大幅度的上涨，对整个产业造成一定的成本压力，从行业内部分上市公司的2021年第一季度报告表现能够有所感知。从公司层面而言，原材料成本上涨会带来一定的成本压力，但总体可控，从2021年第一季度报告看，公司的成本费用率仍在下降，毛利率和净利率指标仍有所提升。

四、半导体业务情况介绍

2020年半导体业务小幅增长，实现收入83,858.42万元、同比增长4.61%，毛利率21.2%、同比下降2.92个百分点，主要因为上海泽丰自5月不再纳入合并报表导致并表收入和利润减少，以及IC封装基板业务新产能投放，因新增人工、折旧以及试生产亏损对整体盈利能力造成拖累。半导体行业目前处于高景气周期，国内呈现供需两旺的格局，从产成品、到原材料都面临供给不足、产品涨价的趋势。

IC封装基板方面：

2020年度，IC封装基板业务实现收入33,615.89万元，同比增长13%；毛利率13%，同比下降4.68个百分点。因疫情影响导致新产能设备装机和投产进度有所延迟，产能爬坡进度受到影响。IC封装基板业务现有产能20,000平方米/月，今年以来除2月份受春节因素影响，一直处于满产状态，良率已提升至96%，市场需求比较旺盛。客户群主要是芯片设计公司和封测厂，国内客户居多，也有部分韩国和台湾客户。IC封装基板未来是公司重点发展的战略方向，也是重点投资的领域，应用领域以存储方向为主。

五、广州兴科半导体封装产业项目情况介绍

项目总投资30亿人民币，其中一期投资16亿人民币，月产能30,000平方米IC封装基板和15,000平方米类载板，其中公司持股41%，广州科学城集团持股25%，大基金持股24%，合伙企业（管理团队）持股10%，目前已完成厂房封顶，计划下半年完成厂房装修和设备安装调试，今年年底进入试生产阶段。

六、定增项目审核进度如何

公司拟实施的非公开发行再融资项目，已收到证监会下发的项目审查第一次反馈意见通知书，目前公司正与中介机构准备书面回复意见。

附件清单	无
日期	2021年7月19日